

リードやダイパッドにギザギザした部分を設けることによって封止樹脂とリー

ドの密着性を向上させることは、本願出願前の周知技術にすぎない（必要ならば、引用文献5及び6等を参照）。

（3）請求項35及び36に係る発明について

・引用文献：1－6

リードフレームの製法として、エッチングやスタンピングは本願出願前より慣用的に行われているものにすぎない。

#### 引用文献等一覧

1. 特開平05－129473号公報
2. 特開昭60－195957号公報
3. 特開平06－140563号公報
4. 特開平01－251747号公報
5. 特開平10－163401号公報
6. 特開昭63－067762号公報

---

#### 先行技術文献調査結果の記録

- ・調査した分野     IPC第7版   H01L 23/12, 23/28,  
  H01L 23/50
- ・先行技術文献     特開平10－012773号公報  
  特開昭63－054759号公報

この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではない。

この拒絶理由通知書についてのお問い合わせ先

特許審査第三部 電子素材加工 審査官 酒井 英夫

電 話   03－3581－1101（内線3424）

FAX   03－3580－6905